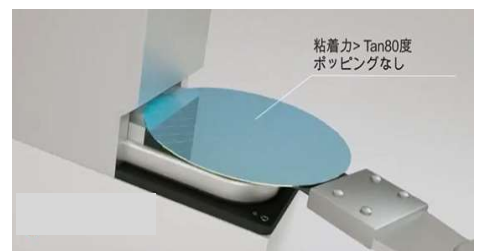


SurfCon®サーフコン

基板の滑りやポッピングを解消する革新的な滑り止めパッド

SurfCon®サーフコンは精密ポリマーエンジニアリングとナノスケールの微細パターニング技術により生まれた乾燥接着(Dry Adhesive)構造の革新的な滑り止めパッドです。

半導体やディスプレイ業界などのあらゆる用途で基板の水平滑りによる位置ずれを効果的に防止するユニークなソリューションです。ウエハ搬送のご用途のほか、ガラス、フィルム、ソーラーセルなどのあらゆる基材の搬送にご使用いただけます。Class10クリーンルームに適用します。



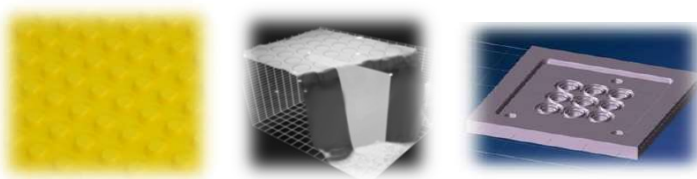
SurfCon®サーフコンは基板ハンドリングの様々な要件を満たす独自のソリューションです。

【導入メリット】

- 基板搬送の高速化を実現しスループットと歩留まりを大幅に改善します
- ポッピング力が非常に小さく、基板搬送中の変位を最小限に抑えます
- SurfCon®自体から発塵しないためパーティクル及び汚染がありません
- 高温対応
- 用途に応じた様々な形状やカスタムデザインが可能
- 既存のパッドからの置き換えが可能



微細パターニング技術



直接描画によるナノスケールの微細パターニング

エッジ及びベベルカット技術 (UV レーザーカット)

厚み・ムラの制御

精密な金型成形

Contents	Data	Parameter	Specification
硬度 (GPa)	4.05E-03	形状	円、角、ドーナツ、埋め込み型
弾性回復(GPa)	1.01E-02	厚み	0.3mm ~
最大使用温度	260°Cまで	直径	~35mm Ø (大きいサイズも可)
アウトガス	260°Cでアウトガス発生なし	COF(摩擦係数)	Tan 80° 以上
耐薬品性	IPA・アセトン: 可 / HCl: 不可	装着方法	粘着テープ or 埋め込み

従来の搬送方法による慢性的な問題を解決するオーダーメイドのソリューションを提供します